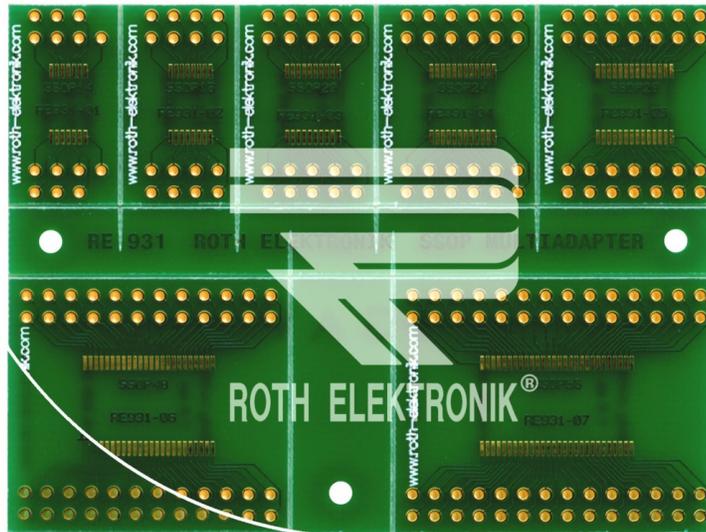


**SSOP-SMD Multiadapter (shrink small outline package)**



**RE931**



- Epoxydglasartgewebe FR4 1,5 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- Löt- und Komponentenseiten mit einer Oberfläche aus chem. AU und Lötstopmmaske
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionplatine für 7 verschiedene SSOP
- pitch 0,65 mm / 0,635 mm
- vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Größe 61,40 x 81,70 mm

Modul-Nr	Pitch	mil	Pin/Anz.	Gehäusegröße (mm)
RE931-01	0,65	22,5	14	5,3 (208 mil)
RE931-02	0,65	22,5	16	5,3 (208 mil)
RE931-03	0,65	22,5	20	5,3 (208 mil)
RE931-04	0,65	22,5	24	5,3 (208 mil)
RE931-05	0,65	22,5	28	5,3 (208 mil)
RE931-06	0,635	25,7	48	7,5 (300 mil)
RE931-07	0,635	25,7	56	7,5 (300 mil)